

絕緣膠技術資料

FeedBond® AP-2100-C1(AB)

產品說明：

FeedBond®AP-2100-C1(AB) 為雙組分，高溫速固型環氧樹脂，專為半導體，光纖等應用而設計。具優良的操作性能和可靠性。

產品特徵：

- 混合比 A:B=10:1，混合後具有良好操作性能
- 高溫速固化或低溫長時間固化
- 具較長的常溫保存性能

硬化前特性	測試條件	測試方法
外觀 A 透明 B 琥珀色 黏度 @ 25°C A 3000±1000cps B 2000±500cps 細度(AB 混合) < 15 μm 使用壽命(混合後) @ 25°C 3 小時 保存期限(未開封) @ 25°C 12 個月	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm 細度計 黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P006 FT-P026 FT-P024 FT-P018
烘烤條件	測試條件	測試方法
標準烘烤條件(熱板)	1 分鐘 @150°C 5 分鐘 @120°C 10 分鐘 @100°C 30 分鐘 @80°C	
機械性質	測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C >3 kg/die @ 150°C >2.5 kg/die	晶片尺寸 45mil × 45mil (銀支架)	FT-M012

註:此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

FeedBond® AP-2100-C1(AB)

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	133°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
硬度 Shore D	80±5	Durometer Shore D	FT-P037
熱膨脹係數 <Tg	45ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
>Tg	189ppm/°C		
儲存模數		DMA(TA), 試片厚度<1.6mm	FT-M019A
@25°C	2356MPa		
@150°C	49MPa		
@250°C	40MPa		
熱重損失		TGA 熱掃瞄	FT-P010
@200°C	0.13%		
@250°C	0.30%		
@300°C	0.58%		

註:此表僅提供一般之測試數據,若您需要詳細的產品規格,請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆常溫保存並裝箱緩衝保護,避免傾倒。若收到貨物有破損或外漏,請立即拍照保存並與我司人員連絡。

解凍處理

未混合前不需冷凍保存,AB混合後若未立即用完,可密封保存於-40°C,下次使用前需待膠品回到常溫後使用。

儲存條件

當您收到貨品時,請放置陰涼乾燥處儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命(保存溫度與產品壽命成正比)

儲存溫度	18~28°C(未混合)	18°C~ 28°C(混合後)
保存期限	12 個月	<3 小時